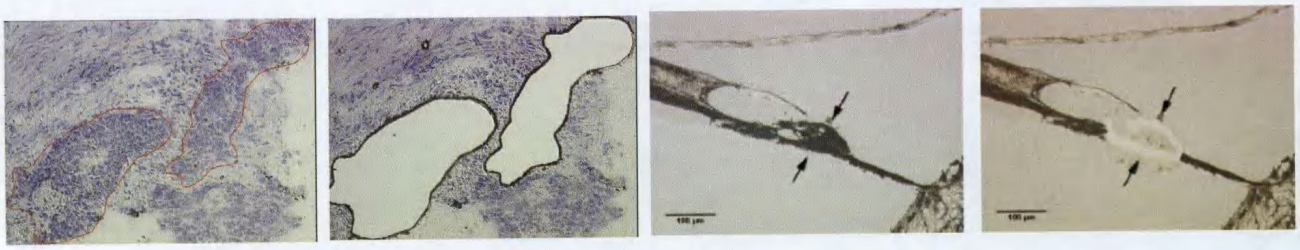
Leica AS LMD激光显微切割系统


显微切割系统

激光显微切割系统是为了从多种细胞构成的组织中获得单纯同类细胞而逐渐发展起来的一项新技术，它可在基本不损伤细胞内蛋白质、DNA和RNA并保持组织形态的条件下，在显微镜直视下从组织切片中高选择性地分离、纯化单一类型细胞群或单个细胞的技术，可有效地克服组织中细胞异质性造成的偏差。显微切割技术的问世，有力推动了肿瘤学、分子病理学、分子生物学等学科的共同发展，充分显示出该技术准确性高、特异性强、与形态学紧密结合、能保证分子结构完整等优越性。目前国际上很多重要的研究，其材料的获取都利用了LMD激光显微切割技术。

检测对象：组织切片（包括：新鲜冷冻组织、存档石蜡包埋组织、细胞爬片等；各种固定剂固定、H&E染色或不染色、免疫细胞化学染色、荧光切片等组织切片均可）。



以上为本科室激光显微切割系统完成样品：切割下的样品可用于基因组分析（如基因突变、基因扩增、染色体易位等DNA水平改变）、转录组分析（如RT-PCR，cDNA微阵列等）、蛋白质组分析（如蛋白质质谱分析、蛋白质二维电泳分析等）。

系统特点：

1. 激光束不接触目标样品，不会产生高热和高能量影响样品。
2. 重力下垂型收集方式，无接触，无污染。
3. 独家高倍镜头 Smart Cut 150×OIL，形态观察更清晰。
4. 应用软件控制可采集微切割前后组织图像，在显微镜下可观察回收的细胞，整个切割过程可在计算机屏幕上实时观察，为实验提供科学依据。